

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2026-036

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、2021年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2689号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币173,832,028.54元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币30,148,456.12元（包括：审计费及验资费12,467,000.00元、律师费10,904,467.37元、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费及材料制作费等2,201,517.05元），募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2021〕第ZI10561号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 11 月 12 日

本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	368,523.90
其中：超募资金金额	171,141.07
减：直接支付发行费用	20,398.05
二、募集资金净额	348,125.85
减：	
以前年度已使用金额	313,760.65
本年度使用金额	9,184.16
银行手续费支出及汇兑损益	28.66
永久补充流动资金	37,146.68
加：	
募集资金利息收入	11,994.30
三、报告期末募集资金余额	0.00

2、2024年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1338号）核准，公司于2025年9月完成向特定对象发行人民币普通股（A股）38,601,326股，发行价格为116.11元/股，募集资金总额为人民币4,481,999,961.86元，扣除各项发行费用人民币46,984,264.81元（不含增值税），募集资金净额为人民币4,435,015,697.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2025]第ZI10808号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 9 月 16 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	448,200.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	4,698.43
二、募集资金净额	443,501.57
减：	
以前年度已使用金额	113,934.18
本年度使用金额	57,560.84
现金管理金额	230,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	6.85

加：	
募集资金利息收入	65.82
三、报告期期末募集资金余额	42,065.52

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

1、2021年首次公开发行股票

2021年11月，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海昌里支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）与招商银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年10月，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）与上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。2024年6月，公司及全资孙公司ACM RESEARCH KOREA CO., LTD.和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）与KB Kookmin Bank Seongnam Hi-tech valley Branch共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，

上述账户已全部销户。

2、2024年度向特定对象发行股票

2025年9月，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国光大银行股份有限公司上海昌里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司与国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025 年 9 月 16 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	458548927208	11,702.52	使用中
盛帷半导体设备（上海）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121938866210008	30,335.05	使用中
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区拱极路支行	1001740619300212673	0.74	使用中
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行陆家嘴支行	121909929210018	9.78	使用中
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司张江支行	03006344991	3.23	使用中
盛美半导体设备（上海）股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	36750180800806631	14.20	使用中
合计			42,065.52	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行临时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。2026年5月20日，公司已将上述临时补充流动资金的全部249,999,701.17元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月，具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站披露的《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-020）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2021 年 11 月 12 日			
临时补充 流动资金 金额	临时补充流动资 金起始日期	计划补充 流动资金 时长	董事会审议通过 日期	归还募集资金日 期	归还募集 资金金额
24,999.97	2025 年 6 月 26 日	12 个月	2025 年 6 月 26 日	2026 年 5 月 20 日	24,999.97

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于

继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-077）。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021 年 11 月 12 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000.00	投资产品	2025 年 8 月 5 日	2026 年 8 月 4 日	2025 年 8 月 5 日

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 9 月 16 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
240,000.00	投资产品	2025 年 10 月 28 日	2026 年 10 月 27 日	2025 年 10 月 28 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2021 年 11 月 12 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
盛美半导体设备(上海)股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	大额存单	大额存单	9,000.00	2023 年 1 月 31 日	2026 年 1 月 31 日	2026 年 1 月 31 日	无	3.15%	850.50

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年度向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2025 年 9 月 16 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
盛美半导体设备(上海)股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	大额存单	大额存单	180,000.00	2025 年 12 月 24 日	2026 年 12 月 24 日	未到期	未到期	1.20%	未到期
盛帷半导体设备(上海)有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	大额存单	50,000.00	2025 年 11 月 14 日	2026 年 11 月 14 日	未到期	未到期	1.40%	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2026年5月26日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议和第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“盛美半导体设备研发与制造中心”项目节余募集资金8,356.73万元，以及首次公开发行股票剩余超募资金28,842.24万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。本事项于2026年6月16日经公司2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年5月27日、2026年6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-026）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-031）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 11 月 12 日

使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	28,843.92	2026 年 5 月 26 日	2026 年 6 月 16 日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026年5月26日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议和第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“盛美半导体设备研发与制造中心”项目节余募集资金8,356.73万元，以及首次公开发行股票剩余超募资金28,842.24万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。本事项于2026年6月16日经公司2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年5月27日、2026年6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-026）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-031）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股票				
募集资金到账日期			2021 年 11 月 12 日				
节余募集资金合计金额			8,302.75				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
盛美半导体设备研发与制造中心	8,302.75	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 5 月 26 日	2026 年 6 月 16 日

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年2月26日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议和第

三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目“研发和工艺测试平台建设项目”的内部投资结构。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2026-010）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年8月8日

附表 1:

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2021 年 11 月 12 日										
本年度投入募集资金总额			9,184.16										
已累计投入募集资金总额			322,944.81										
变更用途的募集资金总额			24,500.00 (注 1)										
变更用途的募集资金总额比例			7.04% (注 1)										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
盛美半导体设备研发与制造中心	研发项目	是	70,000.00	144,500.00	144,500.00	9,184.16	138,051.33	-6,448.67	95.54	2025 年 6 月	10,419.92	是	否
盛美半导体高端半导体设备研发项目 (注 2)	研发项目	不适用	45,000.00	不适用	45,000.00		45,458.74	458.74	101.02	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	65,000.00	不适用	65,000.00		65,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
高端半导体设备拓展研发项目 (注 2)	研发项目	不适用	73,087.15	不适用	73,087.15		74,434.75	1,347.60	101.84	不适用	不适用	不适用	否
盛美韩国半导体设备研发与制造中心	研发项目	是	24,500.00	0.00	0.00			0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
合计			277,587.15		327,587.15	9,184.16	322,944.81	-4,642.34	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目的原因： 由于 2024 年上半年全球营商环境的变化，公司经审慎评估后认为，通过“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目对盛美韩国进行大规模固定资产投资将面临风险。2024 年 12 月 2 日公司及盛美韩国被美国工业和安全局（BIS）列入“实体清单”，也印证了公司前期的预判。 基于上述原因，为了更好地维护公司和股东的利益，规避因全球营商环境变化带来的风险，提高募集资金使用效率，公司经过审慎研究决定终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见专项报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见专项报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	见专项报告三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因	见专项报告三、（七）
募集资金其他使用情况	无

注 1：“变更用途的募集资金总额”是指公司于 2025 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，并将该项目拟投入募集资金 24,500.00 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。该事项于 2025 年 2 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。本处“变更用途的募集资金总额”不包括募集资金利息以及理财收益。

注 2：项目实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 3：表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

附表 2:

2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2025 年 9 月 16 日											
本年度投入募集资金总额		57,560.84											
已累计投入募集资金总额		171,495.03											
变更用途的募集资金总额		无											
变更用途的募集资金总额比例		无											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发和工艺测试平台建设项目	研发项目	不适用	92,234.85	92,234.85	92,234.85	4,794.24	11,917.26	-80,317.59	12.92	不适用	不适用	不适用	否
高端半导体设备迭代研发项目	研发项目	不适用	225,547.08	220,848.65	220,848.65	17,998.00	29,178.24	-191,670.41	13.21	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	130,418.07	130,418.07	130,418.07	34,768.60	130,399.52	-18.54	99.99	不适用	不适用	不适用	否
合计			448,200.00	443,501.57	443,501.57	57,560.84	171,495.03	-272,006.54	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					见专项报告三、（四）								

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	见专项报告三、（八）

注：表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股票												
募集资金到账日期			2021 年 11 月 12 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
无	盛美韩国半导体设备研发与制造中心	不适用	盛美韩国	韩国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025 年 1 月 9 日	2025 年 2 月 11 日
盛美半导体设备研发与制造中心		研发项目	盛帷上海	中国	144,500.00	144,500.00	9,184.16	138,051.33	95.54	2025 年 6 月	10,419.92	是	否	2025 年 1 月 9 日	2025 年 2 月 11 日
合计					144,500.00	144,500.00	9,184.16	138,051.33	95.54	-	10,419.92	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			公司于 2025 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，并将该项目拟投入募集资金 24,500.00 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。该事项于 2025 年 2 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目的原因： 由于 2024 年上半年全球营商环境的变化，公司经审慎评估后认为，通过“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目对盛美韩国进行大规模固定资产投资将面临风险。2024 年 12 月 2 日公司及盛美韩国被美国工业和安全局（BIS）列入“实体清单”，也印证了公司前期的预判。												

	基于上述原因，为了更好地维护公司和股东的利益，规避因全球营商环境变化带来的风险，提高募集资金使用效率，公司经过审慎研究决定终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无